

# 2019 年 SEMICON JAPAN 参加報告書

群馬大学 理工学部 電子情報理工学科  
小林研究室 学部 4 年 山本颯馬

## 1. 概要

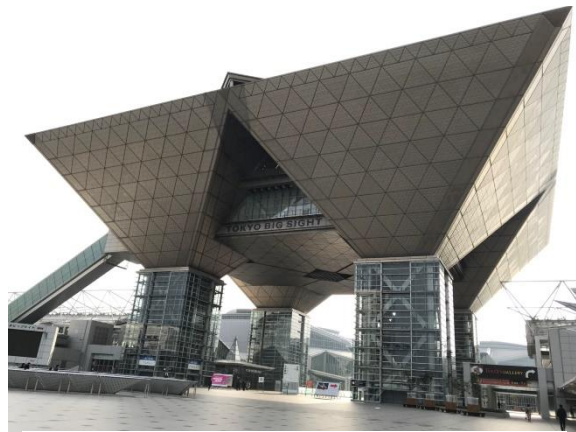
開催期間：2019 年 12 月 11 日(水)～13 日(金)

開催場所：東京ビックサイト

## 2. 感想

東京ビックサイトで行われた SEMICON JAPAN では、約 700 社の多数の企業が集まり半導体の製品や新技術などの展示が行われた。

展示ゾーンは「前工程ゾーン」、「後工程・総合ゾーン」、「部品・材料ゾーン」、「SMART Applications ゾーン」に分かれており、半導体製品の設計から製造、またそれを利用したサービスが展示されていた。



東京ビックサイト



SEMICON JAPAN

今年は 12 月 11(水)～13 日(金)の 3 日間で 5 万人以上の参加者が来場し、出展国数は 15 国であった。

会場内の各出展企業のブースでは、自動車や IoT 機器の内部に使われる半導体製品を実際に見ることができ、技術の高さを実感した。



SEMICON JAPAN 会場

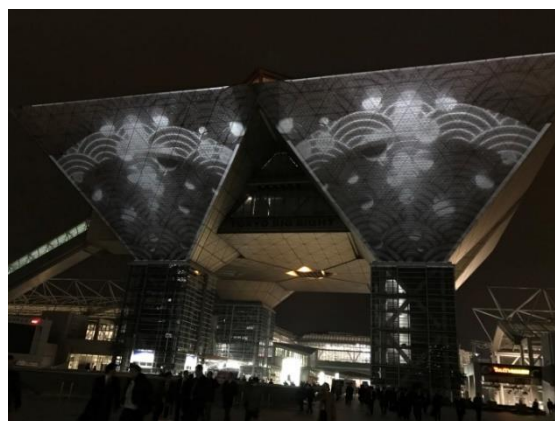


小林研究室の展示

小林研究室では研究内容についてのポスターの展示を行った。ポスターの内容に興味を持っていた大学の先生方や企業の方とお話しすることができ、良い機会になった。

また、大学生・大学院生のための半導体業界研究イベントの「未来 COLLEGE」が SEMICON JAPAN 会場内で行われていた。「未来 COLLEGE」は出展企業の方が学生向けに半導体業界について説明していただけるイベントである。

私は各出展企業のブースを回り、半導体業界の最近の動向や就職活動についてのお話を聞くことができ、とても参考になった。



東京ビックサイト プロジェクションマッピング

### 3. 謝辞

ポスター展示のため研究のご指導を頂いた小林春夫先生、SEMICON JAPAN への参加を支援して頂いた桑名杏奈先生を始め、SEMICON JAPAN の開催を支えてくださった皆様に深く感謝を申し上げます。